

3-1-1-6 シンボルマーク端子部被り／字符爬上插脚 / Symbol mark over edge board contact

【特徴】シンボルマークが部分的に端子部に被っている状態の欠陥

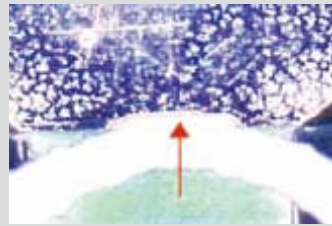
【特征】字符爬上插脚局部的缺陷。

【Characteristics】A symbol mark partially covers a edge board contact.

【起因・判断ポイント・発生工程】シンボルマークが端子部に近づき、滲み状に被って出来たもの（シンボルマーク印刷工程）

【原因、判断要点、発生工序】字符靠近插脚，渗出并爬上所引起的（字符印刷工序）。

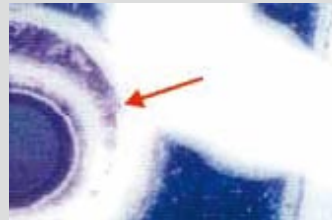
【Causes/processes involved/keys to judgment】A symbol mark is printed too close to a edge board contact and ink partly covers the contact by spreading. (Symbol mark printing process)



【コメント】顕微鏡倍率×125

【注釋】显微镜倍率×125

【Comments】Magnification: ×125



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×

3-1-2 不注意（シンボルマーク欠陥）／疏忽（字符的缺陷）／ Caused by careless mistake(Symbol mark defects)

3-1-2-1 シンボルマーク位置ズレ／字符的偏移 / Displaced symbol mark

【特徴】シンボルマークの位置がズレて、端子部分などに重なっている状態の欠陥

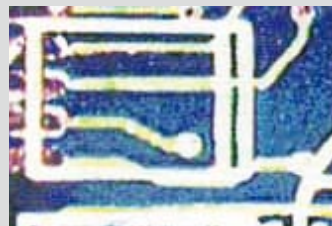
【特征】因为字符偏移，爬上插脚的局部等的缺陷。

【Characteristics】The position of a symbol mark is displaced and overlaps on a conductor, such as a edge board contact.

【起因・判断ポイント・発生工程】シンボルマーク印刷時の、位置決めストッパからの外れや、位置決めストッパのセッティングミス等により出来たもの（シンボルマーク印刷工程）

【原因、判断要点、発生工序】字符印刷时，定位槽偏移或者定位槽の設定差错等所引起的（字符印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】The defect is caused by the board being placed off the positioning stopper or a wrong setting of the positioning stopper in symbol mark printing (Symbol mark printing process)



【コメント】シンボルマークが端子上に印刷されている
顕微鏡倍率×

【注釋】字符爬上插脚
显微镜倍率×

【Comments】Symbol mark is printed on a edge board contact
Magnification: ×



【コメント】シンボルマークがフラットホール上に印刷されている
顕微鏡倍率×

【注釋】字符爬上盲孔
显微镜倍率×

【Comments】Symbol mark is printed on plugged through-hole surface
Magnification: ×